PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-100165

(43)Date of publication of application: 13.04.2001

(51)Int.CI.

G02F 1/13 C03C 15/00 G02F 1/1333

G02F 1/1339 G09F 9/00 // H01L 21/306

(21)Application number: 11-273636

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

28.09.1999

(72)Inventor: KAITA KOICHI

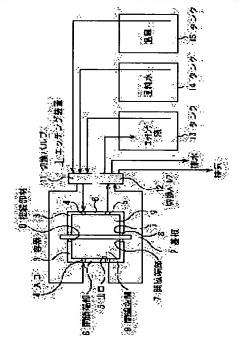
SUGANO YUKIYASU

(54) PRODUCING METHOD OF DISPLAY DEVICE, ETCHING DEVICE AND ETCHING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve such problems that in an etching process to reduce the weight of a liquid crystal panel, it is necessary to apply a protective sealing material on periphery of the substrates because the laminated substrates are wholly immersed in an etching liquid, which complicates the working and requires an extra space, and especially that because an opening formed in the peripheral sealing material after the substrate pair is laminated has to be sealed, another sealing process is added, which decreases the productivity.

SOLUTION: The etching device 1 is used to reduce the thickness of a substrate 2 having a specified thickness by etching the faces of the substrate 2 and is equipped with a container 3 having a closed end 6 where an entrance and an exit 4, 5 are formed and having an open end 7 facing the end 6, a connecting means to bring the open end 7 of the container 3 into contact with the surface of the substrate 2 to form a closed space 9, and



a supplying means to supply an etching liquid 13 through the entrance and the exit 4, 5 to fill the closed space 9 and to etch the surface of the substrate 2. Thus, only the substrate surface can be selectively etched, protection of the end face of the substrate is not especially required.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-100165

(P2001-100165A) (43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

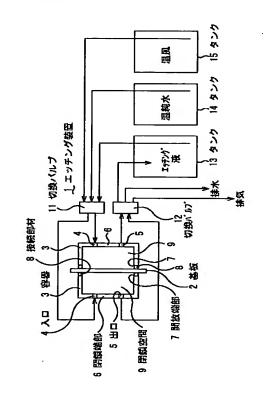
(-) 7	-	AM = .15								
(51) Int. Cl. 7		,.,.	識別記号			FI		テーマコード(参考)	テーマコード(参考)	
G 0 2 F	1/13	1 0	1		G 0 2 F	1/13	101	2Н088		
C 0 3 C	15/00				C 0 3 C	15/00		С 2Н089		
G 0 2 F	1/1333	50	C		G 0 2 F	1/1333	500	2H090		
	1/1339	5 0	5			1/1339	505	4G059		
G 0 9 F	9/00	3 3	8		G 0 9 F	9/00	3 3 8	5F043		
	審査請求	未請求	請求項の数8	OL			(全7]	頁) 最終頁に	続く	
(21)出願番号	特願平11-273636 ·				(71)出願人		000002185 ソニー株式会社			
(22)出願日	平成11年9月28日(1999.9.28)					東京都品	品川区北品	川6丁目7番35号		
				1	(72)発明者	貝田 治	告一			
						東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー				
						株式会社				
					(72)発明者	菅野 🖹	岸保			
						東京都品	引川区北品)	川6丁目7番35号 ン	ノニー	
						株式会社	上内			
				İ	(74)代理人	1000923	36			
						弁理士	鈴木 晴	政		
						最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】表示装置の製造方法とエッチング装置及びエッチング方法

(57)【要約】

【課題】 液晶パネルの軽量化を目的としたエッチングでは、互いに貼り合わされた基板全体をエッチング液に浸漬する為、基板外周に保護用のシール材を塗布しなければならず、作業が複雑化するとともに、余分なスペースが必要になる。特に、一対の基板を貼り合わせた後外周のシール材に形成した開口を封止しなければならない為、封止作業が追加となり生産性を落としていた。

【解決手段】 エッチング装置1は、所定の厚みを有する基板2の面をエッチングして厚みを削るために、出入口4,5が形成された閉鎖端部6とこれに対向する開放端部7とを有する容器3と、容器3の開放端部7を基板2の面に密接して閉鎖空間9形成する接続手段と、出入口4,5からエッチング液13を供給して閉鎖空間9を満たし基板2の面をエッチングする供給手段とを有する。基板表面のみを選択的にエッチングできるので、特別に基板端面などを保護する必要がない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の厚みを有する基板の表面に少なく とも電極を形成する形成工程と、

1

該基板の裏面をエッチングして厚みを削り薄型化を図る エッチング工程と、

該電極に重ねて電気光学層を配する積層工程とを行なう 表示装置の製造方法において、

前記エッチング工程は、出入口が形成された閉鎖端部と これに対向する開放端部とを有する容器を用意する準備

該容器の開放端部を該基板の裏面に密接して閉鎖空間を 形成する閉鎖手順と、

該出入口からエッチング液を供給して該閉鎖空間を満た し該基板の裏面をエッチングする処理手順とを含むこと を特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項2】 前記エッチング工程は、該基板のエッチ ングを完了した後、該閉鎖空間を洗浄液で置換する手順 と、さらに洗浄液を回収した後乾燥用の気体を供給する 手順とを含むことを特徴とする請求項1記載の表示装置 の製造方法。

【請求項3】 前記積層工程は、少なくとも一方に電極 が形成された一対の基板をシール材で互いに接合する手 順と、両基板の間でシール材に囲まれた間隙に電気光学 層として液晶を封入する手順とからなり、

前記エッチング工程は、該一対の基板の少なくとも一方 の裏面をエッチングすることを特徴とする請求項1記載 の表示装置の製造方法。

【請求項4】 前記エッチング工程は、シール材で囲ま れた中央領域とシール材が配された周辺領域のうち中央 領域に属する裏面の部分のみをエッチングすることを特 30 徴とする請求項3記載の表示装置の製造方法。

【請求項5】 所定の厚みを有する基板の面をエッチン グして厚みを削るエッチング方法であって、

出入口が形成された閉鎖端部とこれに対向する開放端部 とを有する容器を用意する準備手順と、

該容器の開放端部を該基板の面に密接して閉鎖空間を形 成する閉鎖手順と、

該出入口からエッチング液を供給して該閉鎖空間を満た し該基板の面をエッチングする処理手順とを行なうこと を特徴とするエッチング方法。

【請求項6】 該基板のエッチングを完了した後、該閉 鎖空間を洗浄液で置換する手順と、さらに洗浄液を回収 した後乾燥用の気体を供給する手順とを含むことを特徴 とする請求項5記載のエッチング方法。

【請求項7】 所定の厚みを有する基板の面をエッチン グして厚みを削るエッチング装置であって、

出入口が形成された閉鎖端部とこれに対向する開放端部 とを有する容器と、

該容器の開放端部を該基板の面に密接して閉鎖空間を形 成する接続手段と、

該出入口からエッチング液を供給して該閉鎖空間を満た し該基板の面をエッチングする供給手段とを有すること を特徴とするエッチング装置。

2

【請求項8】 前記供給手段は、該基板のエッチングを 完了した後、該閉鎖空間を洗浄液で置換し、さらに洗浄 液を回収した後乾燥用の気体を供給することを特徴とす る請求項7記載のエッチング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

10 【発明の属する技術分野】本発明は表示装置の製造方法 とエッチング装置及びエッチング方法に関する。より詳 しくは、表示装置を構成するガラスなどの基板の厚みを エッチング処理により削って軽量化を図る技術に関す る。

[0002]

【従来の技術】液晶ディスプレイによって代表されるフ ラットパネル型の表示装置は、薄く小型で軽量の為携帯 情報機器のディスプレイに広く用いられている。液晶デ ィスプレイなどのフラットパネルは一対のガラス板を接 着し両者の間隙に電気光学物質として液晶を封入した構 造である。ディスプレイサイズが大型化すると、ガラス 板自体の重さも増加する為、軽量化が望まれている。フ ラットパネルを軽くする為には、ガラス基板の厚みを薄 くすればよい。しかし、最初から極端に薄いガラス基板 を用いると、製造段階で破損が生じ歩留りが悪くなる。 特に、上下のガラス基板を貼り合わせる工程で、破損の 問題が多発する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、二枚のガラス 基板を貼り合わせた後、各ガラス基板の露出した面をエ ッチングして厚みを薄くする対策が取られており、例え ば特開平4-116619号公報、特開平5-2494 22号公報及び特開平5-249423号公報に開示さ れている。これらの公開公報に開示された従来のエッチ ング方法を簡単に説明する。図6に示す様に、ガラス板 などからなる二枚の透明基板21,22のそれぞれに、 ITOなどからなる透明電極を形成し、更に、液晶など の配向制御に必要なポリイミドなどの配向膜を形成す る。その後、一方の透明基板21の外周に沿って、接着 剤などからなるシール材23Xを例えばスクリーン印刷 により塗布する。この時同時に、外側のシール材23X で囲まれた内部に、4個のシール材23を塗布する。こ の例は、大きな透明基板21,22から4個のフラット パネルを取り出すものであり、個々のフラットパネルに 対応して内側のシール材23が塗布されている。外側の シール材23Xの一部が切り欠かれており開口24Xが 形成されている。又、内側のシール材23の各々にも開 口24が形成されている。これは、シール材23で囲ま れた領域に、後工程で液晶を注入する為の開口である。 50 これに対し、外側のシール材23Xは、後工程でエッチ

20

ングを行なう際、二枚の透明基板21,22の間にエッ チング液が浸入して、個々の表示装置(液晶パネル)に ダメージを与えることを防止する為に設けられている。 仮に、シール材23Xを透明基板21の外周全体に亘っ て塗布すると、一対の基板21,22を互いに貼り合わ せた時、プレスで圧力を掛ける過程で、内部に閉じ込め られた空気の逃げ場がなくなり、シール材23Xが四方 に飛散する恐れがある。そこで、シール材23Xの一部 を切り欠き空気抜き用の開口24Xを設けてある。排気 の為の開口24Xは数が多い程空気の排気性がよくプレ 10 ス加工の安定性につながるが、後工程のエッチング処理 を行なう前に全て封じる必要がある。

【0004】図7は、二枚の透明基板21,22を互い に接合した後の状態を表わしている。外周のシール材2 3 X に形成された排気用の開口は、前述した様に硬化性 樹脂26で封じられる。図示する様に、大型の透明基板 21,22の内部には、4個の液晶パネルに対応したシ ール材23が閉じ込められており、外部から遮断されて いる。この状態で、互いに接合した基板21,22をそ のままエッチング液に浸漬して、各基板の表面を削り、 薄型化を図る。この時、内部のパネルは外周のシール材 23 Xで囲まれている為、両基板21, 22の間にエッ チング液がしみ込む恐れはない。

【0005】図8は、エッチング処理後の状態を表わし た模式的断面図である。一対のガラス基板21,22の 外表面はそれぞれエッチングを受けて板厚が薄くなって いる。先に板厚が厚い状態で両基板21,22を互いに 接合するので破損の恐れがなく、接合後にエッチングを 行なうことでパネルの軽量化を図っている。この後一点 鎖線で示す切断線に沿って基板21,22を切断し、個30の面をエッチングする処理手順とを行なう。 々のパネルに切り離す。尚、両基板21,22の間には 予めスペーサ27が散布されており、パネルの空隙寸法 を一定にしている。切り離した後、シール材23に形成 された開口24を介してパネルの内部に液晶を注入し、 開口24を封じて表示装置を完成させる。

【0006】ところで、従来のエッチング方式では互い に貼り合わされた基板全体をエッチング液に浸漬する 為、内部のパネルを保護する目的で基板外周にシール材 を塗布しなければならず、作業が複雑化するとともに余 分なスペースが必要になる。特に、一対の基板を貼り合 40 わせた後外周のシール材に形成した開口を封止しなけれ ばならない為、封止作業が追加となり生産性を落として いた。又、従来のエッチング方式では基板全体をエッチ ング液に浸漬する為、基板の端部もエッチングされるこ とになり、処理前後で基板寸法が異なり、後工程での位 置合わせなどに問題を生じていた。

[0007]

【課題を解決する為の手段】上述した従来の技術の課題 を解決する為に以下の手段を講じた。即ち、所定の厚み を有する基板の表面に少なくとも電極を形成する形成工 50

程と、該基板の裏面をエッチングして厚みを削り薄型化 を図るエッチング工程と、該電極に重ねて電気光学層を 配する積層工程とを行う表示装置の製造方法において、 前記エッチング工程は、出入口が形成された閉鎖端部と これに対向する開放端部とを有する容器を用意する準備 手順と、該容器の開放端部を該基板の裏面に密接して閉 鎖空間を形成する閉鎖手順と、該出入口からエッチング 液を供給して該閉鎖空間を満たし該基板の裏面をエッチ ングする処理手順とを含むことを特徴とする。好ましく は、前記エッチング工程は、該基板のエッチングを完了 した後、該閉鎖空間を洗浄液で置換する手順と、さらに 洗浄液を回収した後乾燥用の気体を供給する手順とを含 む。又、前記積層工程は、少なくとも一方に電極が形成 された一対の基板をシール材で互いに接合する手順と、 両基板の間でシール材に囲まれた間隙に電気光学層とし て液晶を封入する手順とからなり、前記エッチング工程 は、該一対の基板の少なくとも一方の裏面をエッチング する。又、好ましくは、前記エッチング工程は、シール 材で囲まれた中央領域とシール材が配された周辺領域の うち中央領域に属する裏面の部分のみをエッチングす

【0008】本発明は、上述した表示装置の製造方法に 適用可能なエッチング方法を包含している。即ち、本発 明にかかるエッチング方法は、所定の厚みを有する基板 の面をエッチングして厚みを削るために、出入口が形成 された閉鎖端部とこれに対向する開放端部とを有する容 器を用意する準備手順と、該容器の開放端部を該基板の 面に密接して閉鎖空間を形成する閉鎖手順と、該出入口 からエッチング液を供給して該閉鎖空間を満たし該基板

【0009】更に本発明は、上述した表示装置の製造方 法に使用可能なエッチング装置を包含している。即ち、 本発明に係るエッチング装置は、所定の厚みを有する基 板の面をエッチングして厚みを削るために、出入口が形 成された閉鎖端部とこれに対向する開放端部とを有する 容器と、該容器の開放端部を該基板の面に密接して閉鎖 空間を形成する接続手段と、該出入口からエッチング液 を供給して該閉鎖空間を満たし該基板の面をエッチング する供給手段とを有する

【0010】本発明によれば、エッチングにより液晶パ ネルなどの表示装置を軽量化する際、エッチングが必要 な基板表面部分のみにエッチング液を供給可能な容器 (カプラー)を備えたエッチング装置を用いている。表 示装置の基板表面のみを選択的にエッチングできるの で、特別に基板端面などを保護する必要がない。加え て、基板端面部はエッチングを受けない為変形が生ぜ ず、製造プロセスでのハンドリングに支障を来すことが ない。

[0011]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施

7

の形態を詳細に説明する。図1は本発明に係るエッチン グ装置の基本的な構成の一例を示すブロック図である。 図示する様に、本エッチング装置1は所定の厚みを有す る基板2の面をエッチングして厚みを削る為の装置であ る。本エッチング装置1は基本的に容器(カプラー)3 を備えている。本実施形態では、一対の容器3を用いて 基板2を前後から挟み込み、両面を同時にエッチングし ている。各容器3は、入口4及び出口5が形成された閉 鎖端部6と、これに対向する開放端部7を有する。各容 器3は接続部材8を介して基板2の対応する面に押圧さ れている。接続部材8は合成ゴムなどからなり、各容器 3の開放端部7を基板2の対応する面に密接して閉鎖空 間9を形成する接続手段の一部となっている。 実際に は、一対のカプラーで基板2を挟み込むことにより、自 動的に閉鎖空間9を形成している。エッチング装置1は 更に供給手段を備えており、入口4及び出口5を介して エッチング液を流動的に供給してカプラーの閉鎖空間9 を満たし基板2の各面をエッチングする。具体的には、 各容器3の入口4は配管及び切換バルブ11を介してタ ンク13,14及び15に接続して、上述した供給手段 20 を構成している。タンク13にはエッチング液が満たさ れており、タンク14には温純水が満たされており、タ ンク15では温風が作られている。一方、各容器の出口 5は配管を介して切換バルブ12に接続している。図か ら明らかな様に、切換バルブ11及び切換バルブ12を 連動的に制御することで、タンク13に満たされたエッ チング液を各カプラーの閉鎖空間9に循環させることが できる。又、エッチングを完了した後、カプラーの閉鎖 空間9をタンク14に満たされた温純水で置換すること ができる。更には、温純水などの洗浄液を回収した後、 タンク15で作り出された温風を閉鎖空間9に送ること ができる。温風は乾燥用の気体として供給されるもので ある。以上の様に、各カプラーは処理の為の流動体を供 給する配管に接続する入口4と、処理液を排出する配管 に接続する出口5とを備えている。これらの出入口を介 して、上述した様にエッチング液、洗浄用の温純水、乾 燥用の温風などが、温度や濃度を制御された状態で、各 カプラーの閉鎖空間9に供給される。カプラーが基板2 の各面と接する部分には、処理用の流動体が漏れ出すの を防ぐ為、合成ゴムなどからなるシールリングが接続部 材8として配置してある。シールリングと接する基板2 の表面のサイドエッチングにより液漏れが発生しないよ うに、シールリングの幅は十分広く取ってある。ガラス 板などからなる基板2の表裏にカプラーを押し付け、規 定濃度のエッチング液を供給し、エッチングを行なう。 エッチングが終了したら、入口4から閉鎖空間9に純水 を供給しリンスする。特に、温純水でリンスすると基板 の乾燥が速く好ましい。リンス終了後、温風を送り込み 基板表面を乾燥させる。

【0012】次に、図2乃至図4を参照して本発明に係 50

る表示装置の製造方法の一例を詳細に説明する。本例で は、液晶表示パネルを製造しているが、本発明はこれに 限られるものではなくフラットパネル構造の表示装置全 般に適用可能である。まず図2に示すように、ガラス板 などからなる二枚の透明基板21,22のそれぞれに、 ITOなどからなる透明電極を形成する。その上に、ポ リイミドなどからなる配向膜をそれぞれ成膜する。その 後、一方の透明基板21の表面に、例えばスクリーン印 刷などでシール材23を塗布する。この際、後工程で液 晶を注入する為の開口24がシール材23に設けられ る。本実施例では、大型の一対の透明基板21,22を 用いて、4個のパネルを取り出す為、4個分のシール材 23を塗布している。但し、個数は4個に限られるもの ではない。本実施例では、図1に示したカプラーを用い てエッチングする為、従来のように基板21,22の外 周に沿って保護用のシール材を形成する必要はない。シ ール材23を塗布した二枚の基板21,22は配向膜が 互いに内側になる様に対向配置し、スペーサ粒子を散布 した状態で間隔が一定になる様に貼り合わせる。

6

【0013】次に、図3に示すように、互いに貼り合わされた基板21,22の各面に、接続部材8を介してエッチング装置1を装着する。この状態で、エッチング装置1により各表示装置20の表面をエッチングできる。互いに貼り合わされた基板の間隙にエッチング液が浸入する恐れがない為、外周に沿って保護用のシール材を設ける必要がなく、従って保護用のシール材の排気用開の封止も必要ない為、生産性が向上する。図示の例では、接続部材8がほぼ各表示装置20のシール材23と整合する部分に配される為、シール材で囲まれた中央領域とシール材が配された周辺領域の内、中央領域に属する部分のみをエッチングすることができる。この中央領域の部分はほぼ表示装置20の画面部に対応している。

【0014】図4は、互いに貼り合わせた透明基板2 1,22の前後から、一対の容器(カプラー)3を接続 した状態を表わしている。接続部材8を介して各カプラ ーを互いに接合した透明基板21,22の前後にセット し、エッチング液を入口4から閉鎖空間9に供給する。 透明基板21、22がガラス材料からなる時は、エッチ ング液として例えばHFの10乃至30%水溶液を使用 できる。エッチング液の温度は10℃から40℃で処理 時間は5分乃至100分程度である。処理時間はエッチ ング量(透明基板の厚みを削る量)に応じて適宜選択す る。例えば、20%HFを用いた場合、一分間で10 μ mの厚みをエッチングできる。従って、元の基板の厚み が0.7mmで、これを0.5mmまで薄型化したい場 合には、20分程度エッチング処理を施せばよい。エッ チング終了後、今度は純水を供給し、エッチング液を洗 い流す。更に温純水を流した後、温風を供給し各基板2 1,22の表面を乾燥させる。エッチングが終了した基 板は、パネルサイズに分断する。分断にはスクライブブ

レーク法やレーザカッター法が使用できる。図示する様に、個々のパネル(表示装置20)は、シール材23で囲まれた中央領域の表面がエッチングで薄くなっている。この中央領域には後工程で液晶が満たされる。一方、シール材23から外側の部分は厚みが元のままである。この部分を切断することで、個々のパネルサイズに分断する。この後、各パネルの開口から液晶を封入した後、開口を封止する。但し、本発明はこれに限られるものでは無く、液晶を封入した後、ガラス基板のエッチングを行なうことも可能である。

【0015】図5は、本発明に従って製造された表示装 置の一例を示す模式的な参考図である。図を見やすくす る為、基板21と基板22を接合するシール材は省略し てある。図示する様に、液晶パネルは土台となる基板2 1とこれに対向する基板22と、両者の間に保持された 電気光学物質とを備えている。基板21,22はガラス やプラスチックからなる。電気光学物質として液晶25 が用いられている。土台となる下側の基板21には半導 体技術を用いて画素アレイ部104と駆動回路部とが集 積形成されている。駆動回路部は垂直駆動回路105と 20 水平駆動回路106とに分かれている。又、基板21の 周辺部上端には外部接続用の端子部107が形成されて いる。端子部107は配線108を介して垂直駆動回路 105及び水平駆動回路106に接続している。画素ア レイ部104には行状のゲート配線109と列状の信号 配線110が形成されている。両配線の交差部には画素 電極111とこれを駆動する薄膜トランジスタ112が 形成されており、画素を構成する。

[0016]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、表示装置を薄型化する為のエッチング工程は、出入口が形成された閉鎖端部とこれに対向する開放端部とを有する容器(カプラー)を用意する準備手順と、カプラーの開放端部を基板の裏面に密接して閉鎖空間を形成する閉鎖手順と、出入口からエッチング液を供給して閉鎖空間を満たし基板の裏面をエッチングする処理手順とを含む。カプラーを用いてエッチングするので、エッチング液が互いに接合した基板の間隙に浸入することがない。従って、従来の様にエッチング液の浸入を防ぐ為にダミーのシール材を基板外周に形成することが不要であり、生産性が向上する。又、ガラスなどからなる透明基板の

端部がエッチングされないので、基板寸法がエッチング 前後で変わらない。この為、後工程での位置合わせ作業 などが容易になる。更に、互いに貼り合わされた一対の 基板のそれぞれでエッチング量を変えることができ、例 えば片側のガラス基板の厚みを比較的厚くし、片側を薄 くするといった加工が容易に行なえるようになる。又、 カプラーの形状を変更することで、エッチングが必要な 部分のみを選択的に処理できる。これまでの様に、エッ チングしない部分をレジストで被覆する工程を省略でき 10 る為、作業性が向上する。例えば、エッチングカプラー の形状により、ガラス基板を分断する部分の厚みを元の ままにしてパネル強度を増すとともに、スクライブ・ブ レイクの条件を変更しない様なことが可能である。加え て、一つのカプラーでエッチング、水洗、乾燥を行なう 為、装置を小型化できる。以上により、LCDにかかわ らず、プラズマディスプレイ、有機エレクトロルミネッ センスディスプレイ等の軽量化されたフラットパネル型 の表示装置を低コストで供給可能である。

8

【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明に係るエッチング装置の基本的な構成を 示す模式的なブロック図である。

【図2】本発明に係る表示装置の製造方法を示す模式図である。

【図3】本発明に係る表示装置の製造方法を示す模式図である。

【図4】本発明に係る表示装置の製造方法を示す模式図である。

【図5】本発明に従って製造された表示装置の一例を示す参考図である。

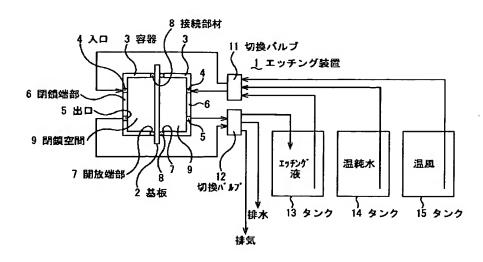
【図6】従来のエッチング方法を示す模式図である。

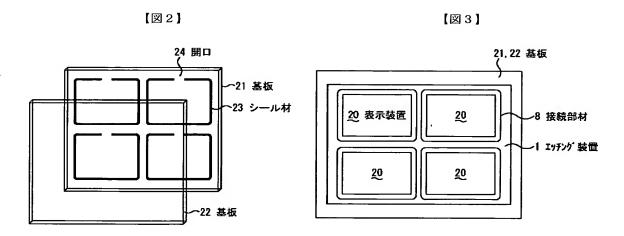
【図7】従来のエッチング方法を示す模式図である。

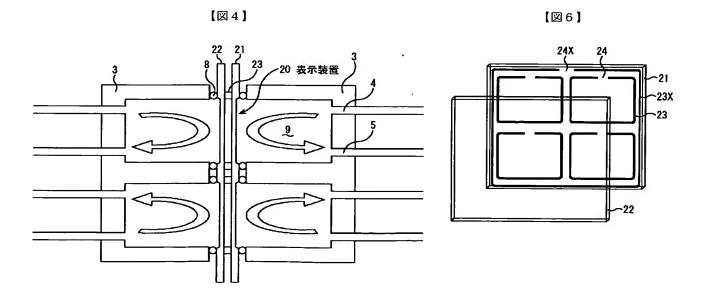
【図8】従来のエッチング方法を示す模式図である。 【符号の説明】

1・・・エッチング装置、2・・・基板、3・・・容器、4・・・入口、5・・・出口、6・・・閉鎖端部、7・・・開放端部、8・・・接続部材、9・・・閉鎖空間、11・・・切換バルブ、12・・・切換バルブ、13・・・タンク、14・・・タンク、15・・・タンク、20・・・表示装置、21・・・基板、22・・・基板、23・・・シール材、24・・・開口、25・・・液晶

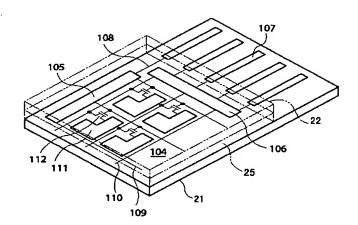
【図1】



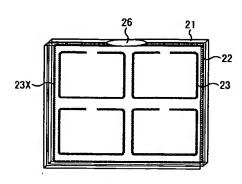




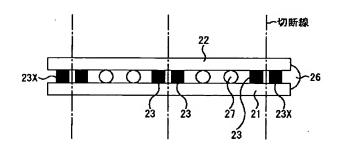
【図5】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

// H O 1 L 21/306

FΙ

H O 1 L 21/306

テーマコート*(参考) J 5G435

Fターム(参考) 2H088 FA03 FA18 FA21 HA01 HA06

HA08 MA20

2H089 NA39 NA60 QA11 QA12 TA01

TA07 TA09

2H090 JB02 JC19 LA03 LA04

4G059 AA08 AC03 BB04

5F043 AA30 AA40 DD23 DD30 EE03

EE15 EE35

5G435 AA17 BB05 BB06 BB12 EE33

KK05 KK10